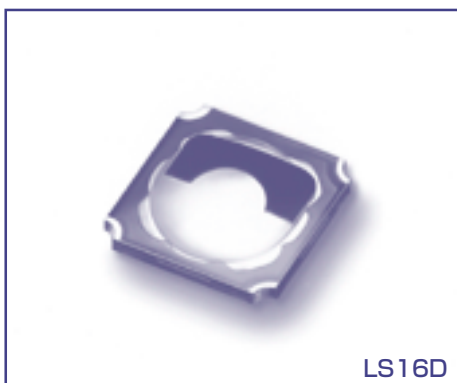
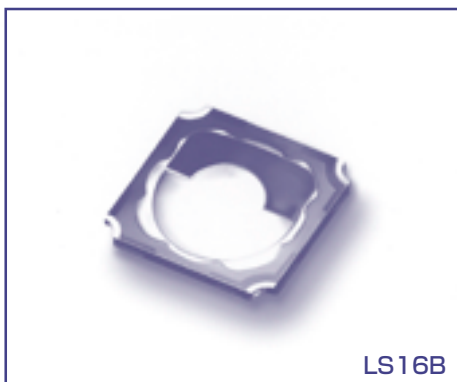
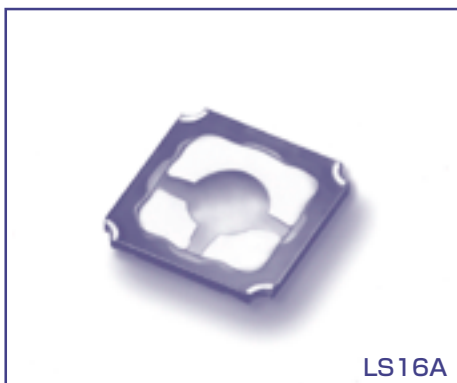


LS16シリーズ

Surface Mountable Switch LS16 Series



特徴 / Features

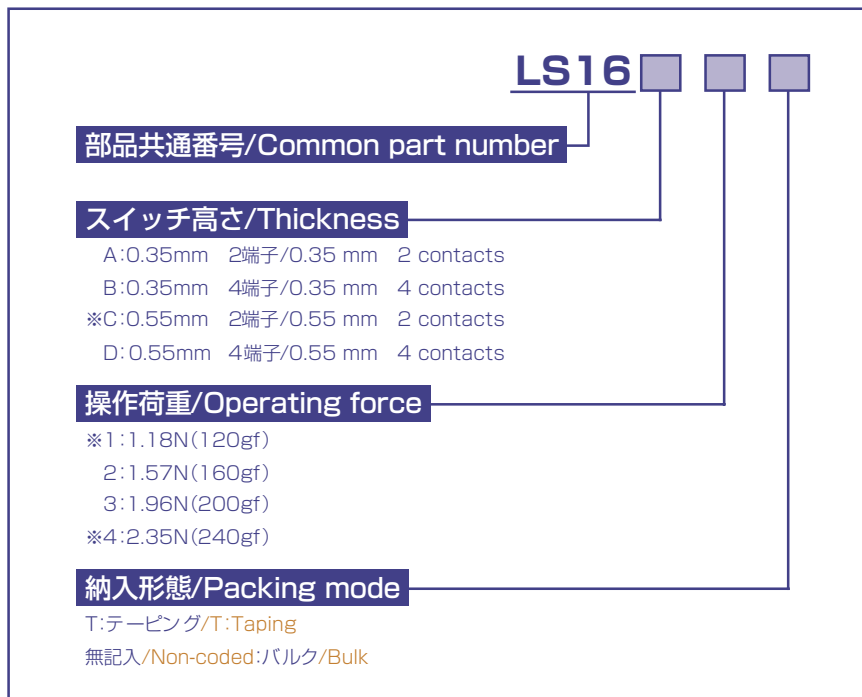
1. 外形寸法4.2mm×4.2mmの基本構造に対し、厚さ0.35mm、0.55mmの新しい発想の超小型薄型タイプの表面実装型スイッチです。
2. 小型であるため実用上のレイアウトの融通性が高く、他のコンポーネントとの共用により大きな自由度を与え、セット設計が容易に行えます。
3. 構造上の有利さと製品の軽さによりチップマウンターでの高速マウントが可能です。
4. リフロー炉によるはんだ付けが可能な完全防水タイプです。

用途 / Application

ルミスイッチLS16シリーズは操作スイッチとして次のような製品に使用できます。
携帯電話、TV、VTR、カメラ等。

LUMISWITCH, LS16 series, can be used as a function control switch in the following applications.
Portable telephones, TV, VCR, cameras, etc.

部品コード / Code for Parts



※製品は未量産品のため、ご使用の際にご相談願います。/Products with an "※" mark are not yet being mass produced. Please contact us when you will be using them.

■電氣的・機械的特性/Electro-Mechanical Characteristics (Ta 25°C)

| 項目/Item | スイッチ作動力/Switch operating force | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 1.18N | 1.57N | 1.96N | 2.35N |
| 最大定格/Maximum rating | DC12V 20mA | | | |
| 接触抵抗/Contact resistance | 100mΩ以下/100mΩ or less | | | |
| 絶縁抵抗/Insulation resistance | 100MΩ以上/100MΩ or more | | | |
| 耐電圧/Withstanding voltage | AC250V 1分間/AC250V for one minute | | | |
| バウンス/Bounce | 20ms以下/20ms or less | | | |
| ストローク/Stroke | 0.2mm | | | |
| 作動力/Operating force | 1.18±0.39N | 1.57±0.49N | 1.96±0.49N | 2.35±0.59N |
| 動作寿命/Operating life (times) | 10万回以上 100,000 or more | 5万回以上 50,000 or more | 5万回以上 50,000 or more | 3万回以上 30,000 or more |

■外形寸法図/Outline drawing

LS16Aタイプ/LS16A type

回路図
Circuit diagram

極性マーク (白)
Polarity mark (White)

シルク印刷
Silk printing

はんだ付け不要タミーパターン
Dummy pattern that does not require soldering

推奨基板はんだ付けパターン
The following soldering patterns are recommended for reflow soldering:

単位/Unit : mm

LS16Bタイプ/LS16B type

回路図
Circuit diagram

極性マーク (緑)
Polarity mark (Green)

シルク印刷
Silk printing

推奨基板はんだ付けパターン
The following soldering patterns are recommended for reflow soldering:

単位/Unit : mm

LS16Dタイプ/LS16D type

回路図
Circuit diagram

極性マーク (黒)
Polarity mark (Black)

シルク印刷
Silk printing

推奨基板はんだ付けパターン
The following soldering patterns are recommended for reflow soldering:

単位/Unit : mm

注1) はんだ印刷用メタルマスクの厚さは0.1~0.15を推奨します。
A thickness of 0.1~0.15 is recommended for the metal mask for solder printing.

注2) 基板レジストパターンの寸法は、はんだ付けパターン外形+0.15(全周)で設計して下さい。
The dimensions of the board resist pattern should be designed according to the outer form of the solder pattern plus 0.15 (all around).

注3) スイッチ中心公差は、スイッチ外形より±0.2mm以下となります。
The switch center tolerance is to be ±0.2mm or less from outside edge of the housing.

※基板パターン処理はAuメッキです。/Board pattern finish is with gold (Au) plating.